

Informations de base	
<b>2018/2947(DEA)</b> DEA - Procédure d'acte délégué  Exemption relative au plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée  Complétant <a href="#">2008/0240(COD)</a>  <b>Subject</b>  3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique 3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur

Acteurs principaux			
Parlement européen	<b>Commission au fond</b>	<b>Rapporteur(e)</b>	<b>Date de nomination</b>
	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">ENVI</span> Environnement, climat et sécurité alimentaire		

Événements clés			
Date	Événement	Référence	Résumé
16/11/2018	Publication du document de base non-législatif	<a href="#">C(2018)07499</a>	
16/11/2018	Période initiale pour l'examen de l'acte délégué 2.0 mois		
28/11/2018	Annnonce en plénière de la saisine de la commission		
24/01/2019	Pas d'opposition à l'acte délégué par le Parlement		

Informations techniques	
<b>Référence de la procédure</b>	2018/2947(DEA)
<b>Type de procédure</b>	DEA - Procédure d'acte délégué
<b>Sous-type de procédure</b>	Examen d'un acte délégué
	Complétant <a href="#">2008/0240(COD)</a>
<b>État de la procédure</b>	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur
<b>Dossier de la commission</b>	ENVI/8/15029

Portail de documentation			
Commission Européenne			
Type de document	Référence	Date	Résumé
Document de base non législatif	<a href="#">C(2018)07499</a>	16/11/2018	

